**國家中山科學研究院**

**109年校園徵才博覽會甄試簡章**

**壹、招募需求：**

依國家中山科學研究院「109年校園徵才博覽會甄試簡章員額需求表」辦理（如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：依本院新進人員薪資核敘基準表之薪資範圍內，核給基本薪。

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)得依條件申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)再任本院員工，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休資遣撫卹法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(持國外學歷者需符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格)。

(一)大學(含)以上畢業。

(二)學、經歷及科系專長需符合員額需求表之學、經歷條件者。

(三)報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

三、其他限制：具有下列情形之一者，不得辦理進用；若於進用後三個月內，本院始查覺者，得取消錄取資格︰

(一)履歷內容填寫不實或於應徵過程中為虛偽意思表示及舞弊者。

(二)大陸地區、香港或澳門地區人士。

(三)無行為能力或限制行為能力。

(四)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告。

(五)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪。但情節輕微且經緩刑宣告者，不在此限。

(六)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢。但情節輕微且經緩刑宣告者，不在此限。

(七)因案被通緝或在羈押、管收中。

(八)依法停止任用。

(九)褫奪公權尚未復權。

(十)受監護宣告尚未撤銷。

(十一)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣。

(十二)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十三)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之處分者。

**肆、報名時間及方式：**

一、甄試簡章及職缺需求刊登於本院全球資訊網 (http://www.ncsist.org.tw)，公告報名至109年2月6日(臺大、成大、交通、中山)、109年2月13日(清大、中央、臺科、北科)止。

二、歡迎具身心障礙身分或原住民族身分，且符合報考資格者報名參加甄試，並於人才資料庫登錄資料時註記。

**伍、活動方式說明：報名資料未繳交齊全或無法辨識者，視同資格不符。各項資料依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳。**

一、填具履歷表(如附件2），並依誠信原則，確實填寫在本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，本院得不經預告終止契約解除聘雇。

二、本次配合校園博覽會場次，凡提前報名的同學，即有機會取得校園博覽會現場面試的機會。

三、將下列1~11資料，全部掃描整理成單一報名資料PDF檔案（限10MB以內，檔名以自己的名字命名）。

1. 「履歷表」以及「自傳」(如附件2)。
2. 在學者請提供「學生證」正反面；畢業者請提供「畢業證書」。
3. 「專科、大學以上在學其間歷年成績單」。
4. 「在學期間個人或團體表現證明」（如專題、論文、競賽成果、獎狀）。
5. 「外語能力證書」（報名研發職類者必要提供，**需有多益550分以上之證書**，或對照CEFR參考架構後其他同等級的證明）。
6. 「其他能幫自己加分的資料」。
7. 提供工作經歷證明者，格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。
8. 若有繳交非我國政府機構之工作經歷證明，需再檢附個人社會保險投保證明(如：勞保、公保、農保…等)，**如未檢附，該工作經歷不予認可**。
9. 具身心障礙身分者，可檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。
10. 具原住民族身分者，可檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。

四、前往「中科院校園徵才活動簡章」中提供的報名連結(<https://forms.gle/kuJWjhsb1GdY4kpLA>），依說明填寫資料，並於最後上傳前述PDF檔案（僅接受PDF檔，限10MB以內），送出後如有看到「感謝您的投遞，我們會盡快與您連絡是否取得面試機會」的訊息，恭喜您已成功報名。

五、報名截止後，我們會針對書面資料進行初步篩選，並透過ncsisthr@gmail.com寄出後續通知。

六、確定參加面試的同學，請於當天指定面試時間前5分鐘至中科院攤位報到，才會保留您的面試預約；未於指定時間前五分鐘完成報到者，依本人抵達現場的時間排入現場後補名單內（現場後補不保證當天都能參加面試）。

七、現場面試活動結束後一個月內，會再通知是否需參加二次面試。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

一、甄試時間：依109年校園場次8場時間  
 (實際甄試時間以甄試通知為準)。

二、甄試地點：暫定109年校園場次8場中科院攤位及面試教室  
 (實際甄試地點以甄試通知為準)。

**柒、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

總機：(03)4712201

聯絡人及分機：李峋 組長350831  
 張靜珍 副組長350860

陳冠吟 小姐350848

附件1

| **國家中山科學研究院109年校園徵才博覽會甄試簡章員額需求表** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作編號** | **職類** | **學歷需求** | **薪資**  **範圍** | **專長** | **工作性質說明** | **合適科系** | **工作地點** |
| 飛彈所1 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 機械/航空 | 1.機械零組件、機構系統及液/氣壓系統之研發設計、分析模擬、製造、組裝、測試驗證。  2.各型火箭發動機之研發及機械關鍵組件設計、測試、分析等。  3.系統工程，包括系統規劃、分析，介面協調、整合等。 | 機械/車輛/航太/造船/輪機/機電/應用力學/動力/系統工程/模具相關理工科系畢業 | 桃園龍潭 |
| 飛彈所2 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 電子/電機/資訊 | 1.系統軟硬體規劃/設計與開發測試。  2.電控系統設計、分析與測試驗證。 | 電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程/物理/工程科學/航太/應力相關理工科系畢業 | 桃園龍潭 |
| 飛彈所 3 | 技術 生產類 | 大學 畢業 | 38,110  |  45,000 | 機械/航空 | 1.各機械零組件/複合材料工件加工/機械模夾具設計與製作等各式傳統與非傳統加工工作。  2.鈑金折彎/旋壓及捲製成型工作。  3.執行風洞試驗設備儀電量測線路配接/檢測及儀電系統工作台操作。  4.致動器/伺服閥/致冷器/慣性儀具/精密液壓組件等組裝測試/系統佈線/信號檢測及驗證/精密零件製作相關工作。 | 機械/機電/車輛/航空/造船/自動控制/兵器相關理工科系畢業 | 桃園龍潭 |
| 飛彈所 4 | 技術 生產類 | 大學 畢業 | 38,110  |  45,000 | 電子/電機 | 1.電路設計、驗測。  2.電機裝備系統安裝、測試、操作、故障診斷及排除。 | 電子/電機/電力控制/控制/電信/光電相關理工科系畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所  1 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 工業工程 | 1.執行合約協商談判及議約工作。  2.執行專案發展規劃、預算、時程、購案、風險、會議及文件等管理工作。  3.專案發展之系統工程業務、產品整合、測試與評估。  4.執行生產管理工作。  5.媒合國內外產學研合作。  6.推廣技轉授權工作。  7.整體後勤支援專案經理人，後勤支援規劃及專案後勤工作管理。  8.後勤工程包括維護度工程、系統安全工程、後勤支援分析及壽期成本分析業務。  9.後勤支援包括支援及測試裝備、供應支援、技術手冊、人員訓練、包搬儲運及產後支援規劃。 | 工業工程/系統工程/資訊/電子/電機/通信/電信/網路/數學/材料等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所  2 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 資訊 | 1.軟體系統架構及模組之分析、設計。  2.軟體程式開發、測試與修改。  3.資料庫、資料結構之規劃設計。  4.三層式網頁應用程式架構設計與程式開發。  5.人機介面設計開發。  6.顯控及演算法程式開發。  7.機器學習/深度學習演算法設計、應用及開發。  8.大數據及人工智慧平台與工具操作。  9.AR/VR/MR系統開發。  10.資訊系統網路連線相關應用程式開發。  11.資料庫資料轉換(ETL)程式開發。  12.執行韌體新技術之研發、導入執行產品韌體測試，開發進度、品質與成本控管。  13.執行測試裝備DSP/MCU韌體研製及系統整合測試工作。  14.執行憑證認證系統開發與建置。  15.產線智能化設計及開發。 | 資訊/電子/電機/電腦/計算(機)/通訊(信)/電信(訊)/網路/軟體/多媒體/動畫/數位/系統工程等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所  3 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 資安 | 1.大型資訊安全相關系統專案架構設計、規劃建置。  2.資訊安全滲透能量建置與訓練。  3.資訊安全稽核及健診檢測能量建置與訓練。  4.系統或軟體安全性研究與相關工具與軟體開發。  5.參與國際網路奪旗CTF競賽。  6.自然語言處理核心模組規劃與研製。  7.雲端系統核心模組規劃與研製。  8.社群網站及與即時通軟體弱點與安全研析。  9.物聯網IOT資訊安全研究及相關軟體開發。  10.密碼學研究及相關軟韌體開發應用。 | 資訊/資管/電腦(計算機)/網路/電機/電子/通訊/通信/電信/電訊/自動控制/系統/數學等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所  4 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 通訊 | 1無線通訊系統基頻演算法Matlab/Simulink模擬分析。  2.以Verilog或VHDL進行FPGA數位電路設計。(如: 通道編碼、調變、數位濾波、同步、跳展頻及通道等化等技術開發及設計)。  3.系統基頻電路整合、測試驗證及分析。  4.微波/遙測系統整合與測試。  5.無線通訊收發機設計、射頻主被動電路設計、干擾處理與性能優化設計。  6.無線電、微波、衛星通信系統規劃分析、安裝測試及維修。  7.高頻段無線通訊應用程式及資料庫設計開發。  8.網路管理程式設計開發。  9.嵌入式系統之基/射頻電路介面驅動程式開發設計。  10.執行通信裝備MCU韌體研製及系統整合測試工作。 | 資訊/通訊/通信/電訊/電信/電子/電機等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所  5 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 電子/電機 | 1.控制系統設計、模擬與軟硬體實作。  2.微處理器、數位/類比電路設計與軟/韌體開發設計。  3.嵌入式系統/微控制器應用設計與實作。  4.數位電路信號處理演算法開發與實作。  5.操作測試設備，並評估元件、模組或系統的正確性和性能。  6.電子系統產品開發先期規劃、成本分析、系統架構研討及顧客需求彙整。  7.計算機硬體、DSP、SoC、嵌入式系統研究、設計開發與檢測。  8.FPGA硬體設計與Verilog、VHDL程式設計開發。  9.Redundant電腦硬體多重備援設計。  10.Linux作業系統Porting、Device Driver設計、開發及維護。  11.電磁波屏蔽效值量測與分析。  12.飛行控制系統分析、設計與模擬。  13.硬體迴路模擬。 | 控制/自動(化)/機電/航空(太)/機械/電子/電機/應用力學/工程科學/系統工程等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所 6 | 技術 生產類 | 大學 畢業 | 38,110  |  45,000 | 資訊 | 1.大數據平台維運管理。  2.DebOps開發流程管理。  3.專案軟體版本管理。  4.資訊安全管理(包括滲透測試與稽核檢測等)。  5.生產管理系統開發與維護。  6.系統軟體佈署安裝與測試。  7.網路、伺服器、視訊系統維護。  8.協助專案資訊系統開發工作事務。  9.維護網路、機房系統及伺服器管理等相關事務。  10.資訊服務主機維運。  11.虛擬平台監控管理。  12.雲端應用系統維運。 | 資訊/電腦(計算機) /電子/電機/通信/電信/統計/資訊管理/工業工程/系統工程/網路工程/數學/軟體工程等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所 7 | 技術 生產類 | 大學 畢業 | 38,110  |  45,000 | 資安 | 1.資安監控中心維運。  2.網路安全架構規劃及安全部署設定。  3.資安設備基礎操作及維運。  4.資安事件處置及調查。  5.軟體模組或系統開發與測試及構型管理。  6.網頁應用程式介面設計開發。  7.資料分析程式開發、除錯與系統操作、維護。  8.雲端應用系統維運。  9.資訊安全滲透測試及稽核檢測。  10.機房管理暨網路工程。  11.負責系統軟硬體及周邊裝置安裝維修。 | 資訊/電腦(計算機)/網路/電機/電子/通訊/通信/電信/電訊/自動控制/系統工程等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所 8 | 技術 生產類 | 大學 畢業 | 38,110  |  45,000 | 通訊 | 1.通信裝備溫篩、震動、EMI/EMC等環境試驗規劃及執行。  2.通信裝備電路焊接、模組組裝、整合測試。  3.裝備操作、維護保養及故障排除。  4.量產電路單板物料採購及相關物料管理系統操作。  5.撰寫使用手冊、安裝手冊或其他客戶支援相關文件。 | 資訊/通訊/通信/電訊/電信/電子/電機等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資通所 9 | 技術 生產類 | 大學 畢業 | 38,110  |  45,000 | 電子電機 | 1.電子電路設計、錫焊、佈線、電路板Layout、電子系統測試、除錯等相關設施維護。  2.操作測試設備，並評估元件、模組或系統的正確性。  3.電子電路與介面測試，系統佈線組裝及整合。  4.微波產品組裝測試。  5.電磁訊號量測與分析。  6.電磁脈衝防護屏蔽效值量測。  7.伺服控制系統測試與修改等相關工作。  8.伺服馬達測試等相關工作。  9.DSP維護等相關工作。" | 工業工程/資訊/電子/電機/電腦/計算(機)/通訊(信)/電信(訊)/網路/數位科技系統等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 材電所1 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 電子/電機/資訊 | 1.影像處理演算法開發與程式驗證  2.DSP嵌入式軟體開發與測試（熟TI DSP為佳）  3.數位信號處理或嵌入式系統開發  4.DSP、FPGA韌體程式撰寫  5.作業系統核心程式開發  6.微處理器程式撰寫與除錯  7.C與Matlab軟體開發  8.軟體撰寫與除錯(測試程式、人機介面、C、C++、C#....)  9.類比電路設計開發(光電轉換訊號放大/電源系統等)  10.數位電路設計與測試  11.成像電路開發與測試  12.視訊訊號介面轉換電路設計  13.微處理器/DSP控制電路設計與測試  14.電路設計(PCB電路)  15.電池管理系統設計  16.自動化程式控制設計 | 資(通)訊/數理/電子/電機/控制/電信/光電/機電/電控等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 材電所2 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 機構設計/機電整合/動力機械/電機/伺服控制 | 1.動態軸承機構系統設計  2.伺服控制/伺服機構架構、規格、控制器設計  3.機電系統整合應用  4.動力機械、電力控制 | 電機/機械/動力機械/航空/輪機/機電/控制/精密等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 材電所3 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | IC半導體 | IC設計、半導體元件設計及製程 | 材料/電子/光電/電機/物理等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 材電所4 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 物理/光電/機械/電機 | 開發與設計雷射系統以及光學檢測系統 | 物理/光電/機械/電機等理工系所畢業。  電機/機械/動力機械/機電/控制/光電等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 電子所  1 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  ︱  85,000 | 電子/電機 | 依分派單位賦予下列一項或多項工作：  1.負責電力電子系統技術規劃整合與設計。  2.負責各型射頻系統之天線元或陣列天線的開發與設計。  3.負責數位類比電路設計及信號處理(含影像)系統技術規劃整合。  4.負責雷達系統整合測試控制及驗證。  5.負責系統自動測試及電磁干擾(EMI)/電磁相容(EMC)/電磁脈衝(EMP)整合設計與規劃。  6.負責微波晶片、元件、模組及系統整合晶片設計與研製。  7.負責DSP晶片、FPGA、GPU或ARM處理器軟韌硬體開發。  8.信號處理與理論分析。 | 電子/電機/電信/控制/通訊等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 電子所  2 | 研發類 | 博士  畢業 | 77,250  ︱  85,000 | 資訊 | 依分派單位賦予下列一項或多項工作：  1.各作業系統平台之軟體規畫、開發與測試(如Windows系統、Linux系統、QT平台程式開發、手機即時APP程式開發、GPGPU/CUDA應用軟體開發等)。  2.主持系統軟體工程相關文件產出及撰寫。  3.雷達系統軟體分析規劃、設計及驗測結果分析。  4平行化運算架構開發設計。 | 資訊工程/資訊網路/多媒體等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 電子所3 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 電子/電機 | 依分派單位賦予下列一項或多項工作：  1.電力電子系統技術規劃整合與設計。  2.各型射頻系統之天線元或陣列天線的開發與設計。  3.數位類比電路設計及信號處理(含影像)系統技術規劃整合。  4.雷達系統整合測試控制及驗證。  5.系統自動測試/儀控程式撰寫/電磁干擾(EMI)/電磁相容(EMC)/電磁脈衝(EMP)整合設計與規劃。  6.微波晶片、元件、模組及系統整合晶片設計與研製。  7.大功率電路設計，及固態發射機線路設計及系統整合測試及驗證。  8.機電/伺服控制/LabView/PLC程式撰寫與規劃。  9.DSP晶片或ARM處理器韌體開發。  10.雷達系統分析模擬。  11.規劃雷達或天線場型驗測方法，系統整合。  12.電子相關類組件、模組、總成及系統等測試開發，熟悉並應用Labview或CVI開發工具。  13.電子零組件工程。  14.TAF實驗室認證。  15.FPGA/ARM/DSP/GPU等晶片軟/韌/硬體開發設計及驗證。  16.電磁模擬、天線互耦分析，以及雷達系統、信號處理等演算法開發驗證分析。  17.系統分析、模擬、規劃、設計、整合。  18.DSP晶片或ARM處理器軟體開發。  19.專案管理。 | 電子/電機/電信/控制/通訊等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 電子所  4 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 資訊 | 1.各作業系統平台之軟體規劃、開發與測試(如Windows系統、Linux系統、QT平台程式開發、手機即時APP程式開發、GPGPU/CUDA應用軟體開發)。  2.嵌入式軟體設計。  3.執行影像辨識與影像處理。  4.系統軟體分析規劃、設計、驗測結果分析及相關文件產出及撰寫。  5.平行化運算架構開發設計。 | 資訊工程/資訊網路/多媒體等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 化學所 1 | 技術 生產類 | 專科 畢業 | 36,050  |  42,000 | 化學/化工 | 1.火工品生產製作、燃速與機性測試、化學原料處理與檢驗分析及化工製程控制等相關工作。  2.化工/化學生產研發設備檢修保養等相關工作。 | 化學/化工/高分子/材料等理工系所畢業 | 屏東滿洲 |
| 化學所 2 | 技術 生產類 | 專科 畢業 | 36,050  |  42,000 | 機械 | 1.機械零組件設計、製圖、組裝加工、測試驗證及裝備維護。  2.火工品生產、模具製作、組裝及拆卸。  3.絕熱層加工、藥柱加工、靜力試驗及製程控制。  4.生產研發設備保養等相關工作。  \*如具車床/銑床/鉗工/機械加工技術士乙級(含)以上證照，請檢附資料 | 機械/機電/模具/車輛/航空(太)/飛機/自動化/船舶/輪機/造船/製造工程/控制/動力等理工系所畢業 | 屏東滿洲 |
| 化學所 3 | 技術 生產類 | 專科 畢業 | 36,050  |  42,000 | 電子電機 | 1.變電站高低壓電力系統運轉操作及維護。  2.化工製程儀電控制系統(含PLC)維護。  3.廠區水電空調工程施工管理及水電相關設施運轉操作維護。  4.館舍、設施機電系統建置及維護等相關工作。  5.火工品生產製作、製程儀器控制等相關工作。  6.生產研發設備保養等相關工作。  \*如具甲種電匠或室內配線技術士乙級或工業配線技術士乙級證照，請檢附。 | 電子/電機/控制/自動化/光電/資工/電資/電化/機電等理工系所畢業 | 屏東滿洲 |
| 資管 中心 1 | 研發類 | 碩士 畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 資訊/資通電領域 | 1.資訊系統及資料庫程式規劃、設計及開發。  2.軟體共通元件、程式風格及人機介面之規劃與設計、轉體測試及構型管理。  3.專案管理、營運管理及流程規劃分析、企業資源規劃(ERP)系統開發等相關工作。  4.通訊、資訊、電信服務領域之專案系統工程管理、規劃設備及系統介面管理與流程。  5.資通電基礎建設相關規劃、設計、開發、系統整合及建置。  6.系統規格發展、系統分析與設計、安裝、測試評估、整體後勤規劃及技術文件發展等相關作業。 | 資訊管理/資訊工程/資訊系統與應用/電腦與通信工程/數據科學與工程/通訊工程/網路工程/多媒體系統與智慧型運算工程/資訊網路與多媒體/工業工程與管理等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 資管 中心 2 | 技術 生產類 | 大學 畢業 | 38,110  |  45,000 | 資通電領域/通信整合系統/總機系統/廣播系統建置維護 | 1.資通電服務領域之專案系統工程執行及履約進度管理。  2.通信整合系統及無線電設備、語音總機系統、廣播系統及IPPBX系統安裝測試、參數設定、調校測試資料分析、故障排除及系統維護。  3.系統安裝規範、系統驗收測試、技術手冊等發展。  4.建立資訊設備報廢處理程序及異常狀況處理。  5.資訊系統開發及維護、資料庫設計開發及維護、軟體測試及構型管理。  6.營運管理及流程分析、企業資源規劃(ERP)系統開發等相關工作。 | 資訊管理/資訊工程/資訊系統與應用/電腦與通信工程/數據科學與工程/通訊工程/網路工程/多媒體系統與智慧型運算工程/資訊網路與多媒體/工業工程與管理等理工系所畢業 | 桃園龍潭 |
| 系製 中心 1 | 研發類 | 碩士 畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 通訊/資工/電子 | 1.執行通訊系統裝備量測及鏈路設計工程。  2.執行自動化系統量測及機電模組除錯作業。 | 通訊/電信/電訊/通訊資訊/資工/資訊網路/資訊科學與工程/網路通訊/電子/電機/自動控制 | 新北三峽 |
| 系製 中心 2 | 研發類 | 碩士 畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 自動控制/PLC控制/資訊 | 1.執行自動化生產線電控系統設計、工具機PLC電控系統設計與維護。  2.自動化生產資訊系統開發與介面整合 | 電子/電機/資訊/控制/電信/光電/工業工程等理工系所畢業 | 新北三峽 |
| 系製 中心 3 | 研發類 | 碩士 畢業 | 56,650  ︱  65,000 | 職業安全衛生 | 1.職業安全衛生管理等相關事項。  2.工作場所及危險性工作場所製程安全評估等相關事項。  3.採購、承攬及工程安全管理、巡檢與稽核等相關事項。 | 職安衛/環工/工業工程/電子/電機/機械/化工/化學/土木等理工系所畢業 | 新北三峽 |
| 系製 中心 4 | 技術 生產類 | 大學 畢業 | 38,110  |  45,000 | CNC車床加工 | 1.武器系統各式機械零組件或複合材料車床加工。  2.機械模夾治具設計與製作。  3.自動化機具操作、故障診斷及排除 | 機械/機電/模具/車輛/自動化/船舶/輪機等理工科系畢業 | 新北三峽 |
| 系製 中心 5 | 技術 生產類 | 專科 畢業 | 36,050  |  42,000 | 水電工程設計 (監造) | 負責設施工程整建改善及計畫委製案等各項水電類工程設計(監造)等業務。 | 電子/電機/機械/機電等理工科系畢業 | 新北三峽 |
| 系製 中心 6 | 技術 生產類 | 專科 畢業 | 36,050  |  42,000 | 土木工程設計 (監造) | 負責中心設施工程整建改善及計畫委製案等各項土木類工程設計(監造)等業務。 | 土木/營建/建築 | 新北三峽 |

附件2

**中科院校園徵才活動履歷表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 | |  | | ★身分證  字號 | | | | |  | | | | 最近三個月  1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | | 年 月 日 | | 婚姻 | | | | | □已婚 □未婚 | | | |
| ★兵役狀況 | | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) | | | | | | | | | | | | |
| ★電子郵件 | |  | | | | | | | | | | | | |
| ★連絡地址 | 戶籍  地址 |  | | | | | | | | | | 行動電話 | | |  |
| 通訊  地址 |  | | | | | | | | | | 連絡電話 | | |  |
| 緊急聯絡人 | |  | | 行動電話 | |  | | | | | 連絡電話 | | |  |
| ★  學歷 | 學校名稱 | | | | 院系科別 | | | | 學位 | | | 起迄時間 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★  經歷  （工讀或計畫助理亦可） | 服務機關名稱 | | | | 職稱(工作內容) | | | | | | | | 起迄時間 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 家庭成員  ★ | 稱謂 | 姓名 | | | 職業 | | | | | 服務機關 | | | 連絡(行動)電話 | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三親等親屬及朋友  在中科院任職之  ★ | 關係(稱謂) | | 姓名 | | | | | 單位 | | | | | | 職稱 | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | | | | 體重：　　 　　　公斤 | | | | | | | | 血型： 　　　型 | | |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | | | | | | | | 族 別：　　　 　　　　　族 | | | | | |
| 身心  障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | | | | | | | | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) | | | | | |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 自傳(請以1頁說明) |
|  |

(本表若不敷使用請自行延伸)　　　　　　填表人：　　 　 （簽章）

(提醒：整份履歷表、自傳連同其他資料必需彙整為一個PDF檔案後再行上載)

**報名資料PDF檔案可參考下列內容依序排列或增減**

1. 履歷表及自傳(以中科院校園徵才活動簡章內提供的格式為主)
2. 畢業證書(已畢業者提供，**未畢業者請提供在學學生證**)
3. 專科、大學以上在學期間歷年成績單
4. 外語能力證明文件（報名研發職類者必要提供，**需有多益550分以上之證書**，或對照CEFR參考架構後其他同等級的證明）
5. 具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請視簡章內容列出的職缺工作內容，補充相關證明)
6. 相關專業工作經歷證明(請視簡章內容列出的職缺工作內容，補充相關專業證明文件)

七、其它補充資料或特殊需求(請視簡章內容列出的職缺工作內容，補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)